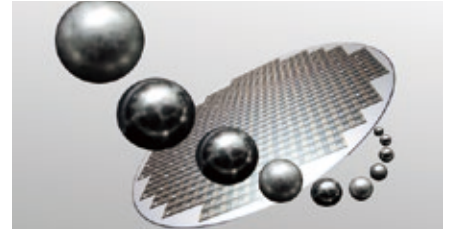


特点

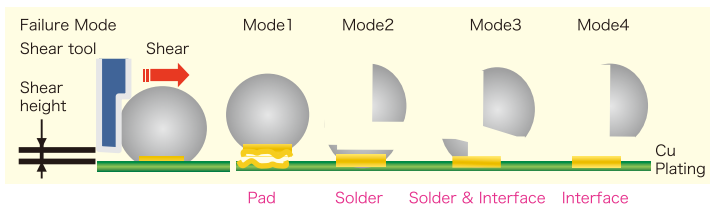
- M758在晶圆电极中形成接合强度较高的凸点
- M758在晶圆电极等镀铜膜中具有良好的浸润性
- 封装后的M758耐热疲劳特性优越



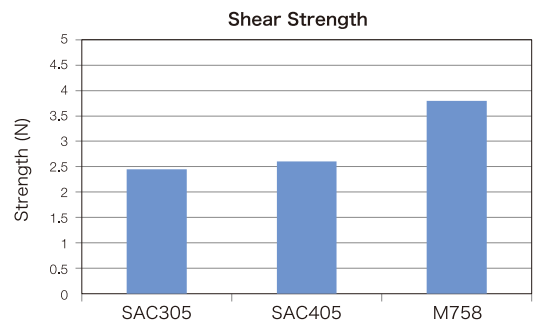
规格

- M758在晶圆电极中形成接合强度较高的凸点

破坏模式



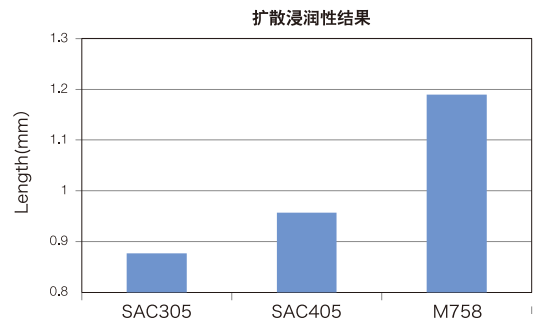
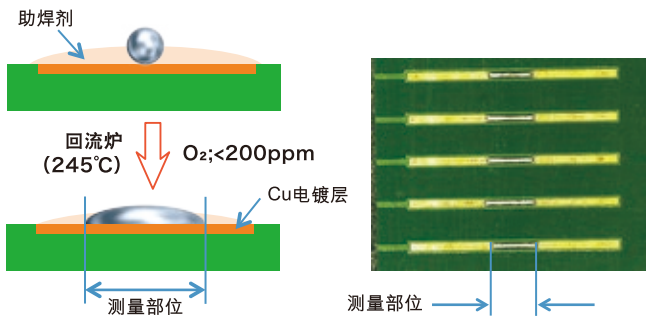
试验中的破坏模式全都是Mode4:界面破坏



通过添加Ni的界面改性效果，M758在PKG等级上具有良好的凸点强度

- M758在晶圆电极等镀铜膜中具有良好的浸润性

试验方法

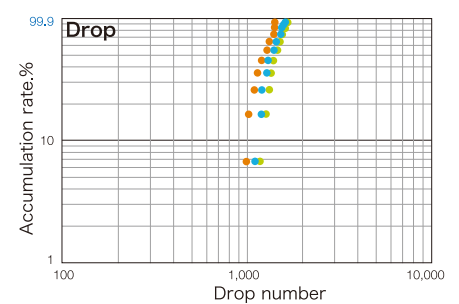
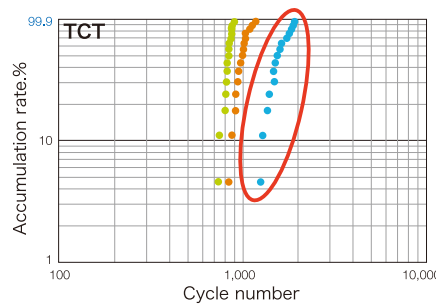


M758在实施镀Cu的PKG上具有良好的浸润性

- 封装后的M758在温度循环试验中显示良好结果



Product Name	Composition	Melting Point (%)	Note
M705	SAC305	217-220	Pb-free Standard
M710	SAC405	217-229	
M758		205-215	Suitable material for WLP



通过添加Bi实现固溶强化，M758与以往产品SAC305、SAC405相比较，耐热疲劳特性更佳此外，耐落下冲击性方面拥有同等及以上的良好结果